

株式会社ジェイ・イー・ティ

2025年12月期
第1四半期決算説明資料

2025年5月9日

The left half of the slide features a detailed, stylized illustration of a blue circuit board. The board is filled with intricate patterns of lines, representing traces and components, with a glowing effect that suggests electronic activity.

2025年12月期第1四半期 連結決算概要 通期予想

韓国メモリーメーカー向け装置の立上遅延等により減収
利益も製品構成の問題などあり、厳しい決算に

売上高
2,531百万円

前期比 $\triangle 9.5\%$

営業利益
 $\triangle 594$ 百万円

前年同期実績
56百万円

経常利益
 $\triangle 627$ 百万円

前年同期実績
 $\triangle 14$ 百万円

当期純利益
 $\triangle 453$ 百万円

前年同期実績
 $\triangle 45$ 百万円

- ✓ 第2次トランプ政権稼働に伴い世界景気に不透明感強まるなか、エレクトロニクス製品等の世界的な消費停滞が継続
- ✓ 中国については、ここ数年間の成熟世代半導体向け新規設備投資増強の反動からファウンドリにて設備稼働率が停滞、メモリーにおいてもDRAM及びNANDフラッシュの価格が下落、投資減速の傾向が続く

連結業績

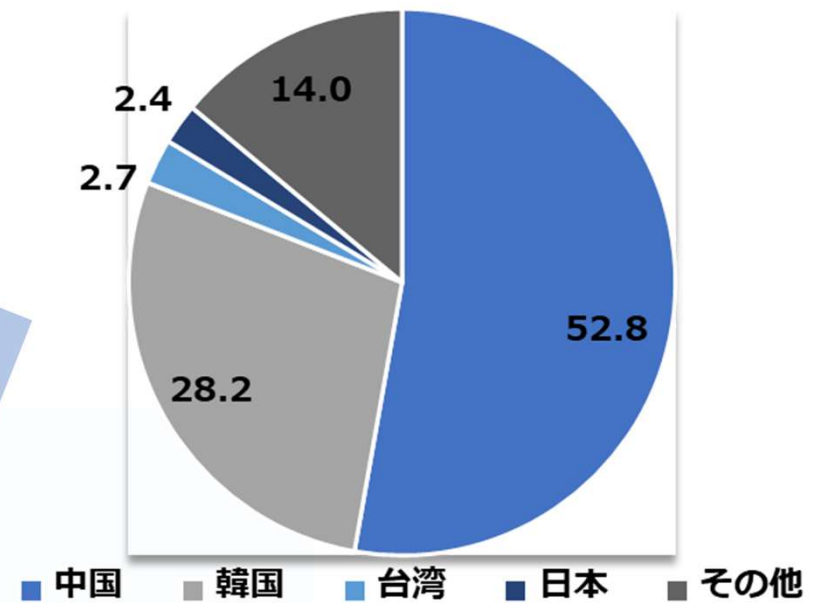
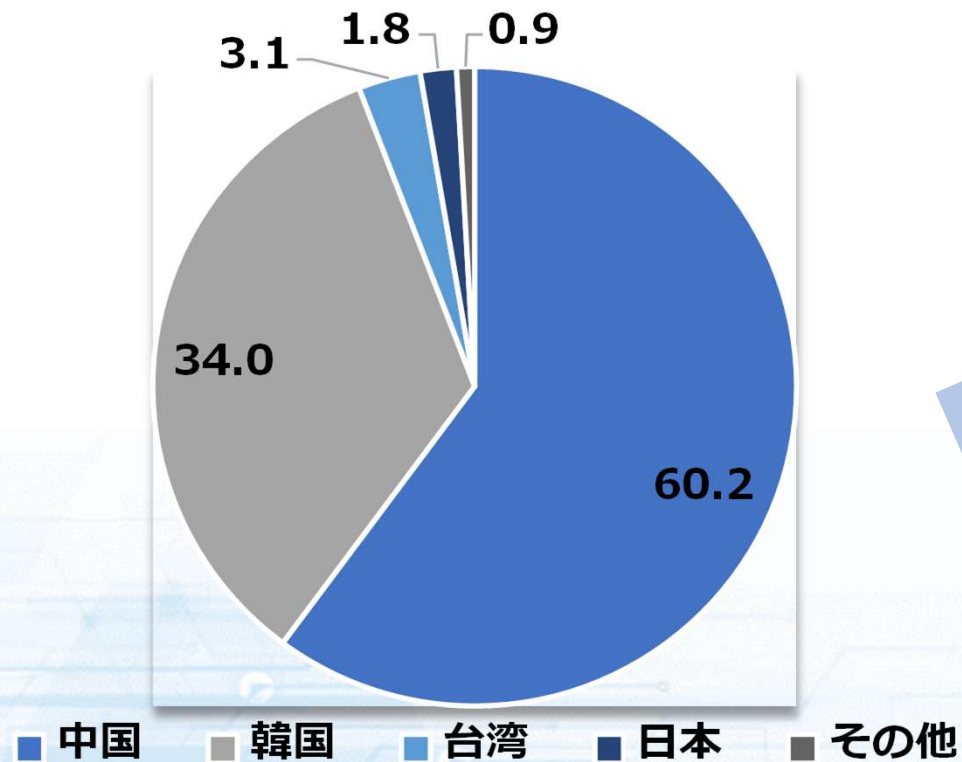


単位（百万円）	2024年 1 Q	売上比（%）	2025年 1 Q	売上比（%）	対前期比（%）	通期予想	進捗率（%）
売上高	2,796	—	2,531	—	△9.5%	18,820	13.4%
売上総利益	667	23.9%	2	0.1%	△99.7%		
販管費	610	21.8%	596	23.5%	△2.3%		
営業利益	56	2.0%	△594	—	—	790	—
経常利益	△14	—	△627	—	—	690	—
当期純利益	△45	—	△453	—	—	370	—

単位未満切り捨て

- ✓ 売上高は前期比9.5%減収、営業利益段階から 1 Qは赤字に
- ✓ 引き続き販管費を抑制も、利益について中国市場で国産メーカーと競合の上受注した案件やカスタマズ要素の多い新規案件など利益率の低い装置を計上したため厳しい業績に

半導体事業 地域別売上高構成比推移



連結貸借対照表

単位（百万円）	2024年12月期	2025年 1 Q	増減	主な増減要因
流動資産	23,824	24,542	718	「現金及び預金」「商品及び製品」の増加 「原材料及び貯蔵品」の減少
有形固定資産	831	809	△22	
無形固定資産	101	112	11	
投資その他資産	734	901	167	
資産合計	25,491	26,365	874	
流動負債	8,575	10,188	1,613	「前受金」の増加
固定負債	4,446	4,344	△102	長期借入金の減少
負債合計	13,021	14,532	1,511	
純資産合計	12,469	11,832	△637	「利益剰余金」の減少
負債純資産合計	25,491	26,365	874	

単位未満切り捨て

2025年12月期 通期市場環境見通し

市場環境はより不透明感が増大

- ✓ 第2次トランプ政権の関税措置など通商政策を受け、市場の不透明感は増大
米中貿易摩擦もより深刻さを増し、世界景気の停滞が懸念される環境
- ✓ エレクトロニクス製品やEVの世界的な消費停滞の影響で、ファウンドリの稼働率は引き続き停滞
- ✓ メモリーについても、一時持ち直したDRAM価格は下落、NANDフラッシュも厳しい

2025年12月期通期業績予想

厳しい環境ながら、以下の施策を通じ増収増益の達成を期す
また、次の飛躍に向けた体制整備、装置開発に注力する

売上高
18,820百万円

前期比 5.2%増

営業利益
790百万円

前期比 0.0%増

経常利益
690百万円

前期比 4.0%増

当期純利益
370百万円

前期比 16.0%増

- ✓ DRAMの高容量化、NANDフラッシュの高層化などに対応し、市況に左右されず投資計画を実行する韓国メーカーに向け、新たな洗浄装置の提案を強化
- ✓ 米国子会社を通じた米国での新規顧客開拓強化
- ✓ 日本市場におけるセンサーおよび車載半導体向け等の顧客開拓強化
- ✓ 中国市場に対するBW3500拡販促進

2. 今後の成長戦略

長期連結業績（売上高・営業利益）推移

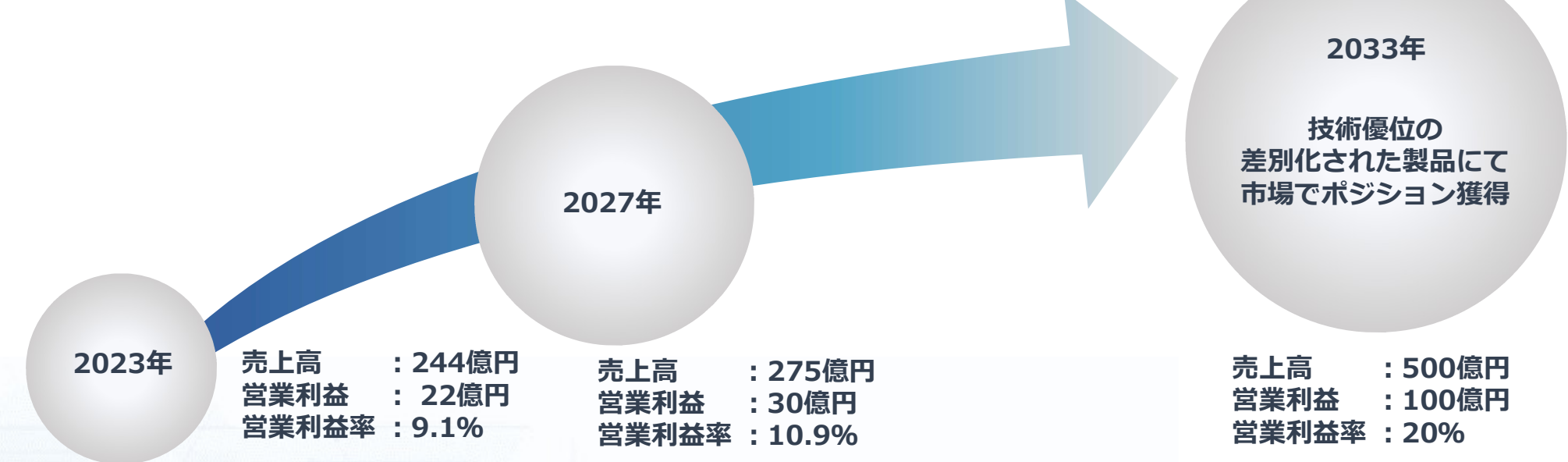
シリコンサイクルの影響を受けながら、これまでも半導体需要の増加に伴い成長
米中貿易摩擦やシリコンサイクルの関係で当面は我慢の時期なるも、次の飛躍に備え体制整備を強化



* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

中長期 数値目標と4つの軸での戦略

市場環境を考慮し、2027年売上高275億円、営業利益30億円、営業利益率10.9%を目指す
2033年には売上高500億円、営業利益100億円、営業利益率20%を目指す



製品戦略

- ・ バッチ式洗浄装置
処理槽の構成や設置数のカスタマイズ性の高さを訴求
- ・ 枚葉式洗浄装置
高温高粘度薬液への対応を推進し差別化を図る
- ・ GXへの対応
硫酸を使用しない洗浄装置の開発等GXへの対応を行う

エリア戦略

- ・ 主要市場(韓国、中国、台湾)
既存のリレーションを通じ取引濃化を進める
- ・ 米国市場：現地法人を開設、“レガシー半導体領域”での顧客開拓に注力
- ・ 日本市場：日本の優位性が高い車載用半導体や、国内回帰を進めるメーカーの開拓強化

組織戦略

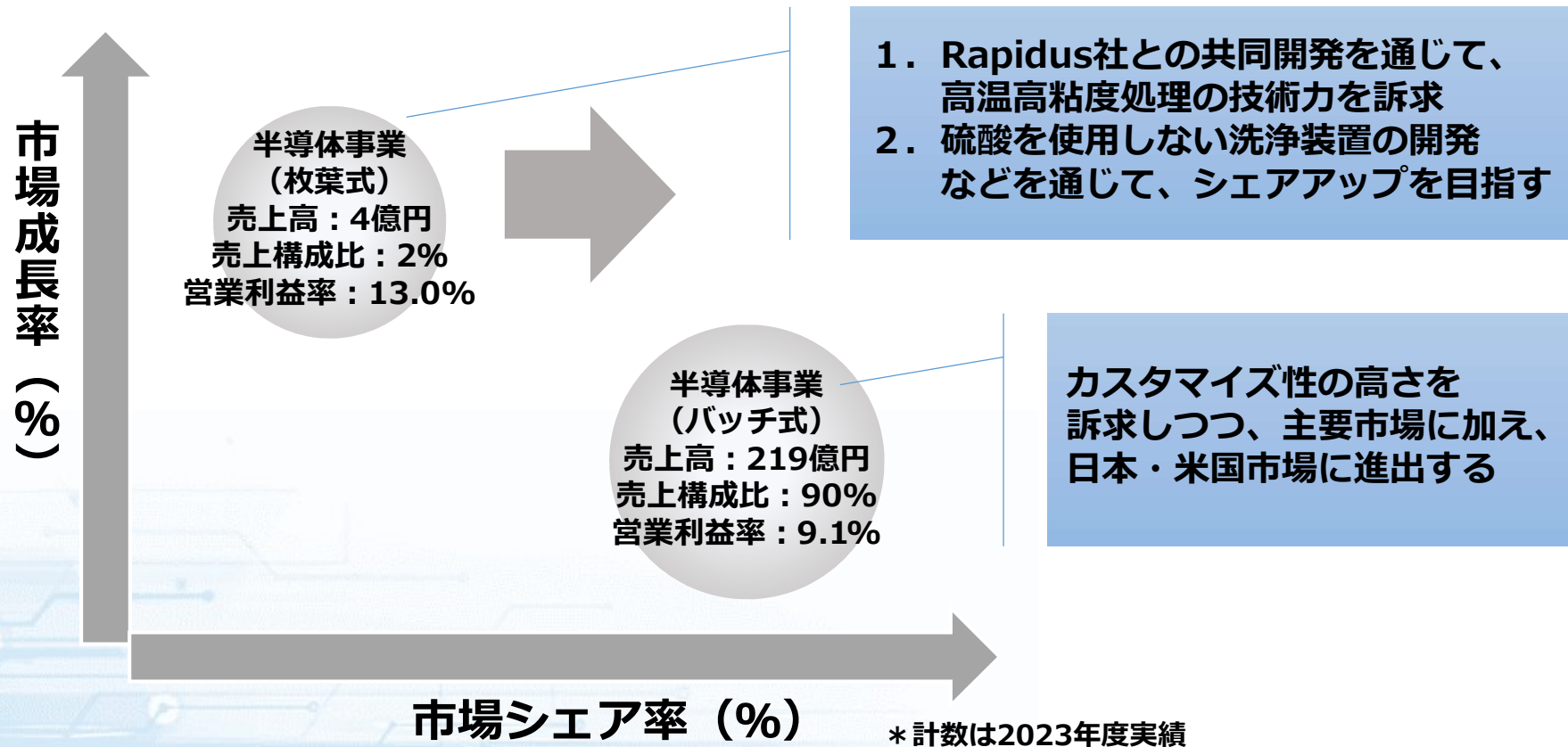
- ・ システムデザイン部の新設
当社の強みは、カスタマイズ性の高さと高温高粘度処理の技術。房野CEOの指導の下、一流の技術営業部隊を育成し、質の高い提案型営業を実現する
- ・ 営業強化：米国へは初めて、日本へは15年ぶりに進出。商文化の違いを踏まえ顧客開拓

製造戦略

- ・ サプライチェーン強化
景気変動の影響を強く受ける半導体業界において、生産能力の弾力化は必須。協力会社との関係を強化し、ファブレス化を推進する
- ・ 新工場建設：生産能力の拡大や生産効率化、R&Dの強化を企図し新工場を建設する

戦略 成長への事業ポートフォリオ整理

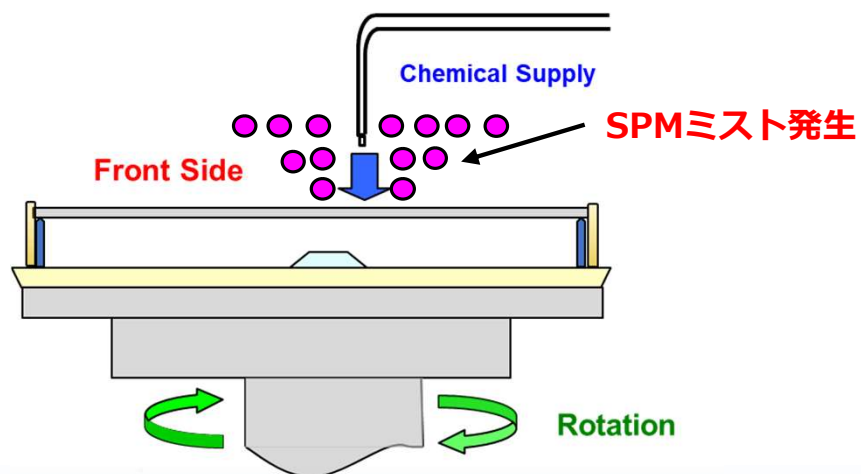
バッチ式のシェアを守りつつ、差別化された枚葉式洗浄装置で成長を期す



- バッチ式洗浄装置は、今後も一定の市場規模を維持しつつ、半導体市場の成長に伴い緩やかに市場成長する見通し
当社は世界シェア11%を占めており、今後も市場シェア率の拡大を目指す
- 枚葉式洗浄装置は、今後も主要な洗浄装置である可能性が高く、半導体の市場の成長に伴い大きく市場成長する見通し
当社は高温高粘度処理に対応した枚葉式洗浄装置の開発・販売を通じて、市場シェアの拡大を目指す

当社 枚葉式装置の優位性

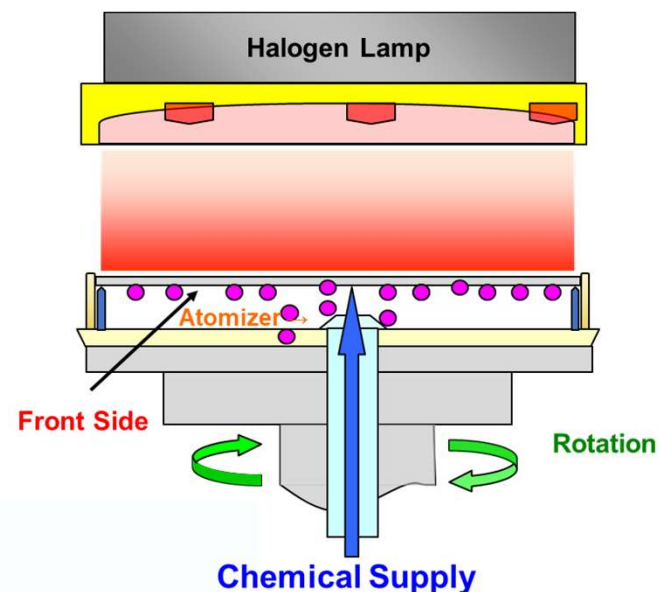
A/B社 枚葉式SPM装置



【他社仕様】

- ・ケミカルの反応熱を利用(150~200℃)
➡ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- ・プロセス時間 : 5min/Wafer
➡必要ケミカル量 : 3000ml/Wafer
(5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為)
- ・SPMミストによりパーティクル発生量が多い

当社 枚葉式SPM装置 (HTS-300)



【JET仕様】

- ・ハロゲンランプにて昇温(200~240℃)
➡**高温維持が容易**
- ・プロセス時間 : **0.5min**/Wafer
➡必要ケミカル量 : **150ml**/Wafer
(他社の**約20分の1**の使用量)
- ・処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用することで
SPMミストが拡散せず、**パーティクルの発生量を抑制**

当社の技術優位性を生かした枚葉式洗浄装置を開発へ

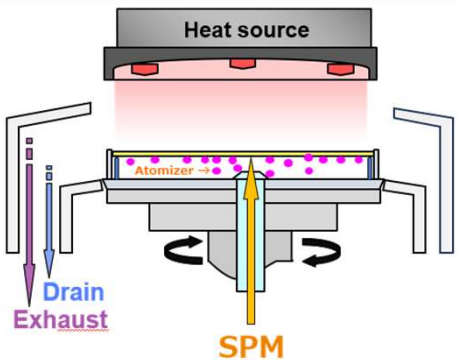
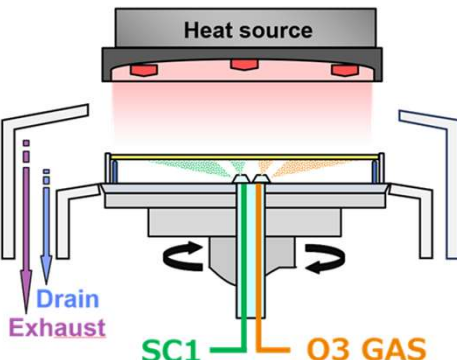
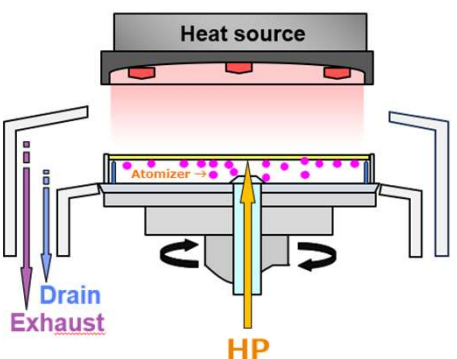
新HTS

1. 硫酸以外のプロセス対応
2. 薬液（プロセス）別製品型式対応
3. リン酸は日本での実績を → 横展開
4. O3（オゾン）は台湾での実績を → 横展開

2033年

技術優位の
差別化された製品にて
市場でポジション獲得

当社 枚葉式装置のプロセス種類

薬液種類	JET装置	イメージ	機能と性能
SPM(H₂SO₄) 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	HTS HTS-300		薬液使用量の削減 ・プロセス時間の大幅短縮により薬液使用量は他社の20分の1にまで削減 ・ヒータによる温度制御によって高いレジスト除去性能を実現 効率的な処理が可能に ・除去したレジストは重力で落下するため、パーティクル軽減
O₃ GAS 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	EcO₃ OMR-3000		環境への負荷が少なく、ランニングコストも低い ・枚様式SPM装置の構造を生かし、O₃ GASでの処理を実現 ・O₃ GASを使用することで環境負荷を軽減しながらSPM同様のプロセスが可能 ・酸とアルカリによる反応生成物が形成されないため、1つの処理モジュールでSC1処理可能
HP(H₃PO₄) Front side SiN除去	Rush HPR-3000		枚葉装置初の高温高エッチングレート処理 ・JETの特許技術を活用し、最先端の窒化膜処理を枚葉式装置で実現 ・高いウェハ均一性を実現 ・高温維持により、高いエッチングレートを実現
HP(H₃PO₄) Back side SiN除去	Rush HBE-3000		

Rapidus社からの開発業務

- Rapidus社はIBM社と戦略的パートナーシップを締結し、2nm半導体の開発・生産を目指す
- Rapidus社は多品種少量生産で「どこよりも速い」半導体製造の実現を目指し、全枚葉式を軸としている
- 製造装置は基本的にIBM社ラインの装置が導入されるが、リン酸エッチング処理についてはIBM社ラインに枚葉式がなく、別途開発が必要となっている（当社が開発中）
- 現状、研究開発段階（α機）を終え、試作装置製作に関する研究開発（β機）段階、2025年には試作機を納入
- 当社は2027年量産ラインへの当社装置納入を目指す



**Rapidus千歳工場（IIM）
2023年9月起工
2025年試作ライン立ち上げ、
2027年量産ライン立ち上げ予定**



HTS-300

主力機種BW3000が開発から20年を経過、より顧客ニーズに応えられる後継機種として、BW3500を開発

- 今後投資の中心になる**28nm以上のプロセスをターゲットに**
- RCA洗浄の他社製品からの切替を意識

現在、中国及び韓国で引き合いに対応中 来期以降の横展開に期待

BW3000からの改善点

1. フットプリントの削減
(装置面積にて15～16%、装置全長で20%の削減)
2. 新たな搬送方式の採用
(搬送アームに加え、Moving / Single Liferによる搬送)
3. 環境・安全対策
(OHT専用PORTの設置、薬液雰囲気漏れ軽減の機密性向上)
4. 破損防止対策 (樹脂槽の採用)
5. 操作性向上 (操作画面の大型化、カラー化、情報量アップ)

ほか、ONE BATH、メタルイオン対策、新排気システム、薬液使用量削減、スループット向上、新乾燥システムの採用などを実現



BW3500

Appendix

会社概要

半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービスを展開



リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身
同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、
販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD.（以下、「ZEUS」）の全額出資のもと、
2009.4.24に設立、2009.5に**エス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生**

■ 会 社 概 要

会 社 名	株式会社ジェイ・イー・ティ
-------	---------------

英 訳 名	J.E.T. Co., LTD.
-------	------------------

設 立	2009年4月
-----	---------

資 本 金	1,848百万円（2024年12月31日時点）
-------	-------------------------

所 在 地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
T E L	0865-69-4080

代 表 者	代表取締役 CEO 房野 正幸
-------	-----------------

従 業 員 数	169名
	293名 ※連結会社含む全従業員数
	(2024年12月31日時点)

事 業 内 容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービス等
---------	----------------------------

主 要 納 入 先	サムスン電子（韓国）SMIC（中国）
-----------	--------------------

グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



所在地： 大韓民国
京畿道華城市

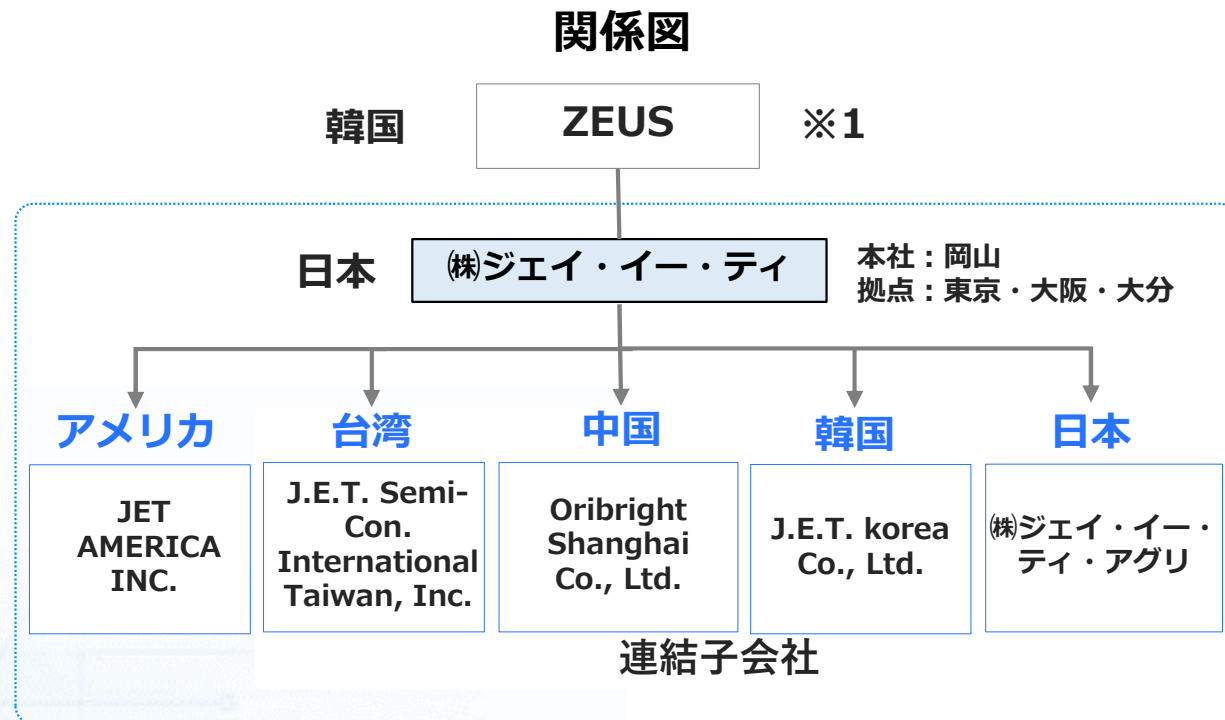
資本金： 15,530,995千KRW

事業の内容： 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の保有割合(%)： 66.3%（直接）

関連当事者との関係： 営業取引

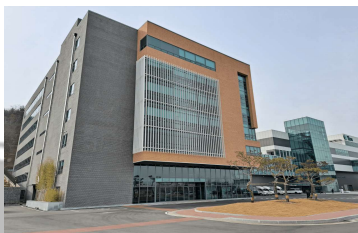
取引の内容： 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

■ 国内拠点
■ 海外拠点



**韓国拠点
23名**

J.E.T. korea Co., Ltd.

Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所

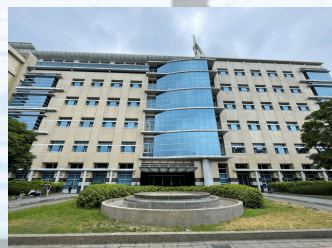
Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



中国拠点 73名

* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(HEAD Office) 台湾本社



**台湾拠点
21名**

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(Singapore branch) シンガポール支社

シンガポール 3名

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

九州出張所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※3)

本社 (岡山)



- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供。
- ※2 大阪事務所は、LIB製品の営業を担当。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培。



JET AMERICA INC.

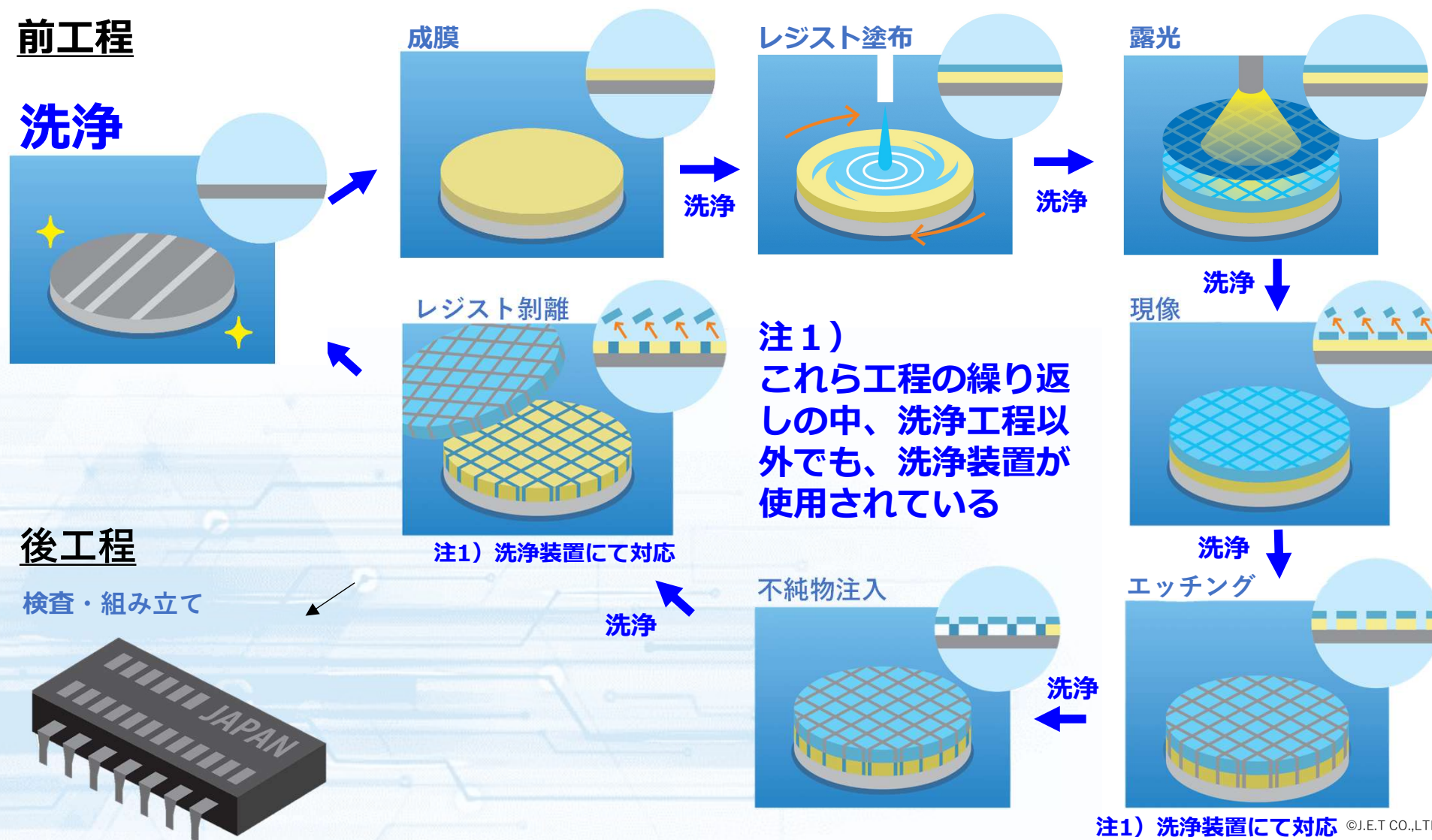
**米国拠点
3名**

半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

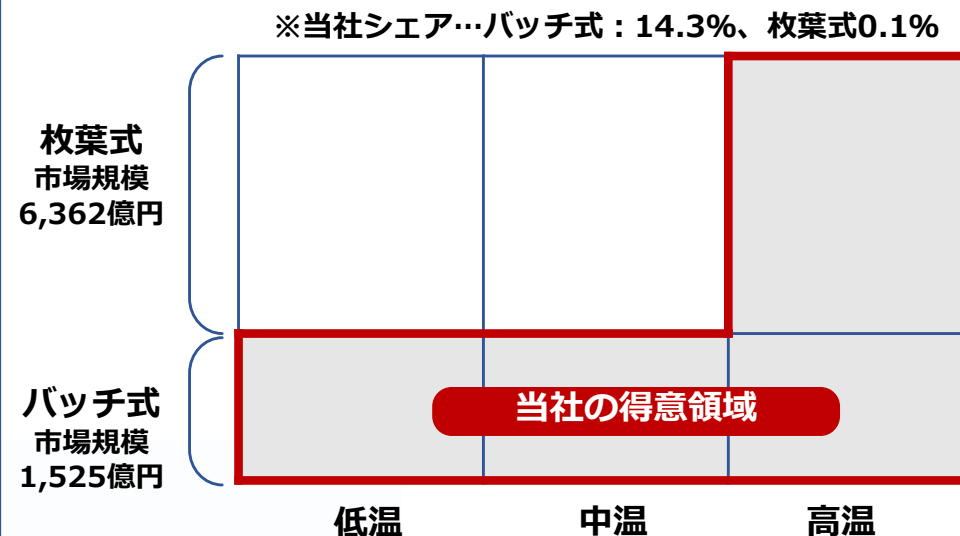
前工程

洗浄



半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社の得意領域

		バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要		25～50枚のウエハを一括洗浄	ウエハを1枚ずつ洗浄
長所		生産性が高い	精密な洗浄が可能
短所		ウエハの塵を拾い易い	生産性が低い
現状		生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主流洗浄装置
高温高粘度処理	特徴	プロセス温度維持が容易	プロセス温度維持が難しい
	硫酸	○（主流）	△（一部対応）
	リン酸	○（主流）	×（対応なし）
市場規模（2023/世界）		1,525億円 （当社シェア 14.3%）	6,362億円 （当社シェア 0.1%）



競合状況と差別化要素

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

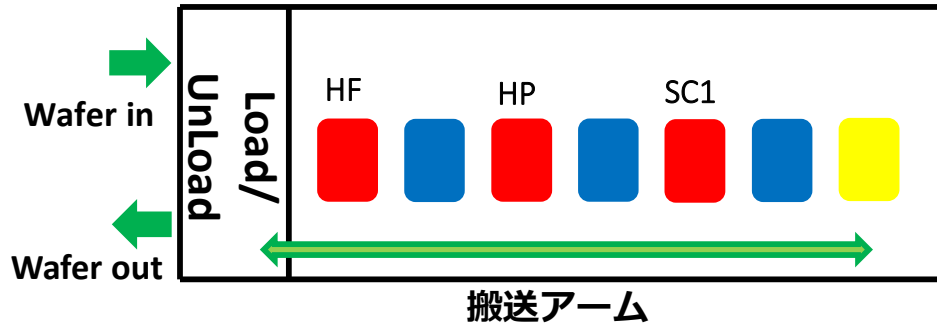
		当社	A社	B社
会社規模 (2023年度 売上高/営業利益)		250億円 (26億円)	5,049億円 (941億円)	1兆8,305億円 (4,562億円)
シェア (2023年度の 市場規模)	バッチ式 (1,525億円)	14.3% (218億円)	49.3% (752億円)	21.6% (329億円)
	枚葉式 (6,362億円)	0.1% (4億円)	47.3% (3,007億円)	20.7% (1,318億円)
技術	RCA洗浄	△	◎	○
	硫酸洗浄	◎	○	△
	リン酸洗浄	◎	○	△
	その他	○	△	○
生産能力		△ (量産能力は低い)	◎ (量産能力あり)	◎ (量産能力あり)
カスタマイズ性		◎ (カスタマイズ性に強み)	△ (標準化装置に強み)	△ (標準化装置に強み)

(出所) 経済産業省「令和5年6月 半導体・デジタル産業戦略」より、評価は当社独自の認識

- 当社の競合他社は、売上規模が数千億円～数兆円の大企業で、高品質で標準化した装置を量産できる点が強み
- 当社は量産能力に劣るものの、難易度の高い高温高粘度処理やカスタマイズ性の高さに強みがある
大企業が参入しづらいニッチ領域へ、小回りの利く当社が参入し、シェアを獲得している状況

JETバッチ装置の優位性⇒ 唯一F-Typeを持つ

I-Type A社 / B社 / 当社

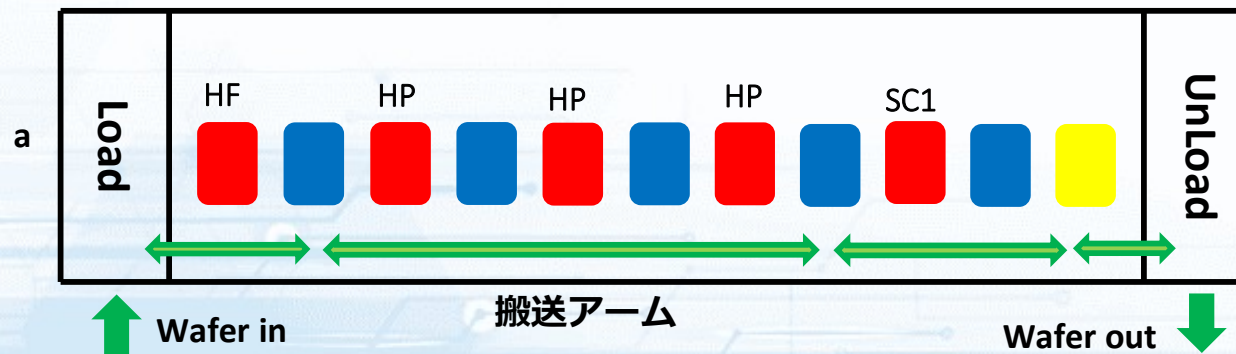


 ケミカル槽
 水洗槽
 乾燥機

特徴

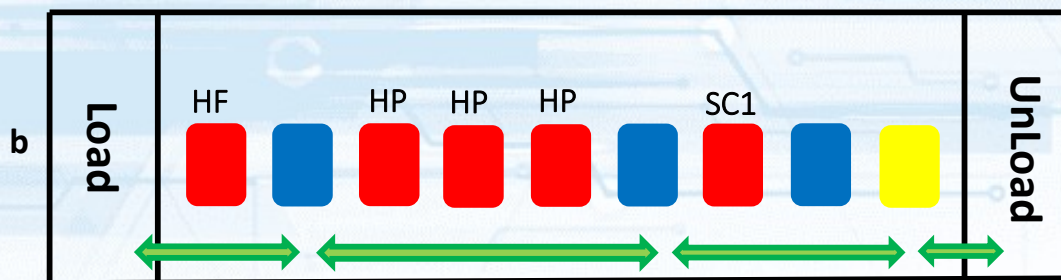
- ・ コンパクト
- ・ 処理槽 MAX 8 槽
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- ・ スループット 最大250w/h

F-Type 当社のみ



特徴

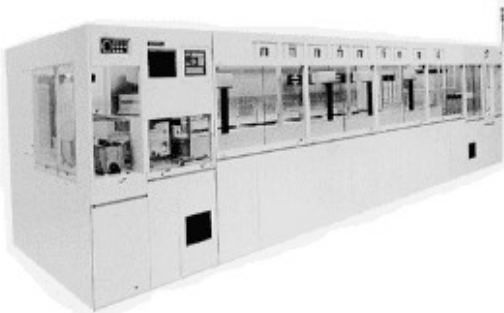
- ・ 少し大きい
- ・ 処理槽 MAX14槽
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- ・ a/b 選択可能
- ・ bはケミカル槽を連続配置可能
- ・ 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- ・ **スループット 最大 500w/h**



* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能） ◎生産効率の向上 ◎500WPHに対応する高速LD/ULD ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎二酸化炭素の低減 ◎気体流量のコントロールを実現 ◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮 ◎SEMI standardに対応 ◎EES（EDA or TDI）に対応	◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化 ◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現 ◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少 ◎気泡発生の低減化を実現 ◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上 ◎濃度の安定性を向上 ◎豊富な処理槽種類に対応 ◎1薬液プラス1DIW構成に対応
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

当社主要製品②

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	◎高い生産効率 ◎高い洗浄能力 ◎省フットプリント ◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応）	◎最小150ccの薬液消費量での処理を実現 ◎最高240℃での高温処理を実現 ◎最短30秒でのストリップ処理を実現 ◎ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現
価格帯 （平均単価） （百万円）	150～210	330～540

サステナビリティ経営メッセージ

上場企業として、サステナビリティ経営についてはしっかりした取り組みが必要
業績的に踊り場のこの時期に企業としての体制を強固なものにする意味も含め

2024年12月13日 サステナビリティ経営方針を公表

2025年4月15日 サステナビリティ委員会を設置

半導体洗浄装置において、環境負荷の低いプロセスにて代替える
洗浄装置の開発により、社会に貢献すべく尽力しております。

またここ数年の売上増大に対応すべく新工場を建設予定であり、最先端技術の導入による生産性の向上、研究開発の加速を図るとともに、社会的価値への貢献として環境にやさしい地域社会との共生を実現できる工場にしたいと考えております。

企業は人なりの考えのもと、2017年以降、毎年5~7名の新卒社員を採用してきており、加えて新たな中堅社員の採用にも積極的に取り組んできました。新たな人財教育システムを含む人事制度を導入し、人財の早期戦力化を目指していきます。

サステナビリティ経営方針

株式会社ジェイ・イー・ティ サステナビリティ経営方針

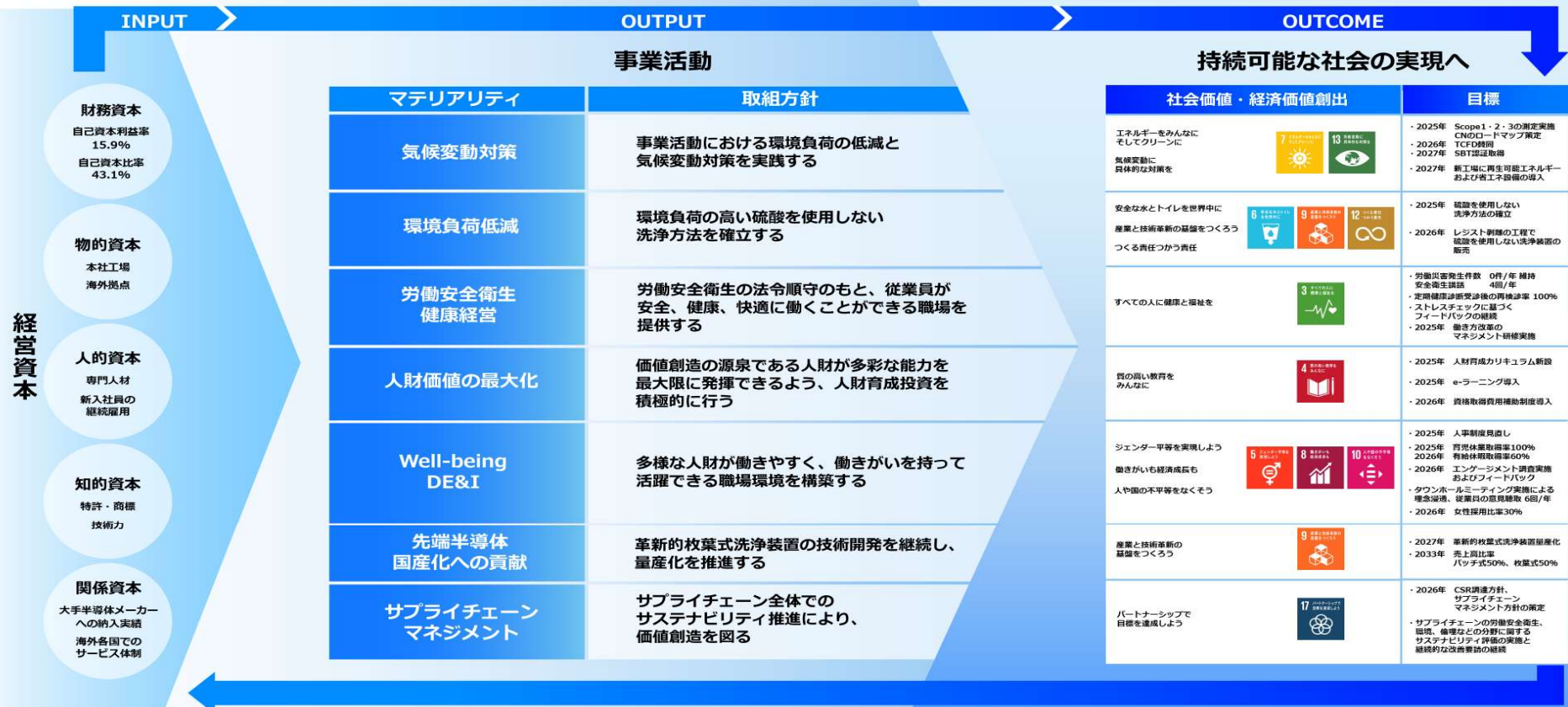
サステナビリティ経営メッセージ Sustainability management policy

半導体洗浄装置において、環境負荷の低いプロセスにて代替する洗浄装置の開発により、社会に貢献すべく尽力しております。またここ数年の売上増大に対応すべく新工場を建設予定であり、最先端技術の導入による生産性の向上、研究開発の加速を図るとともに、社会的価値への貢献として環境にやさしい地域社会との共生を実現できる工場にしたいと考えております。企業は人なりの考えのもと、2017年以降、毎年5〜7名の新卒社員を採用してきており、加えて新たな中堅社員の採用にも積極的に取り組んできました。新たな人材教育システムを含む人事制度を導入し、人材の早期戦力化を目指してまいります。

企業理念

◆ ミッション：お客様第一主義に徹し、強い会社・良い会社づくりに邁進し、人を大切に、社会貢献に努めてまいります

◆ ビジョン：技術優位の差別化された製品にて、世界市場で然るべき立場を獲得します
◆ プリンシプル：未来をつくる6つの約束（クレド）を基本に考え、行動します



外部環境

マクロ環境

社会：(機会) 急激な技術革新や半導体を使用するデバイスの市場拡大
政治経済：(機会) デカップリングの影響による米国、日本等での新たな投資
技術：(機会) AI半導体及び関連するメモリーパワー半導体の性能向上、市場への普及
自然など：(機会) 環境にやさしい薬液への置き換え

(脅威) 需給バランスの悪化から価格が下落し投資が一時的に縮小するリスク
(脅威) 米中貿易摩擦、地政学リスク等による輸出停止

ミクロ環境

顧客：(機会) 新たな投資計画
サプライヤー：(機会) 韓国、台湾、中国等の現地メーカーの技術力向上
競合先など：(機会) 該当なし

(脅威) 半導体製造装置の自国での調達、大規模投資計画の変更
(脅威) 円安、部材高騰による仕入価格の高騰
(脅威) 新興洗浄機メーカーの技術力向上

マテリアリティ（重要課題）と取組方針

マテリアリティ(重要課題)	取組方針
1. 気候変動対策	事業活動における環境負荷の低減と気候変動対策を実践する
2. 環境負荷低減	環境負荷の高い硫酸を使用しない洗浄方法を確立する
3. 労働安全衛生・健康経営	労働安全衛生の法令順守のもと、従業員が安全、健康、快適に働くことができる職場を提供する
4. 人財価値の最大化	価値創造の源泉である人財が多彩な能力を最大限に発揮できるよう、人財育成投資を積極的に行う
5. Well-being・DE&I 注1)	多様な人財が働きやすく、働きがいを持って活躍できる職場環境を構築する
6. 先端半導体国産化への貢献	革新的枚葉式洗浄装置の技術開発を継続し、量産化を推進する
7. サプライチェーンマネジメント	サプライチェーン全体でのサステナビリティ推進により、価値創造を図る

注1) Well-beingとは、 ➡ 「身体的、精神的、社会的に満たされている状態」
 DE&I（ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン）とは ➡ 「多様性」を「受容・包括」し、
 それぞれに「公平」な機会提供のもとで、互いに尊重しながら成長できる環境づくりを目指した考え方

本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2025年5月9日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しが変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ
経営戦略部

TEL 0865-69-4281